

					Таблица 1		
Условное	Наименование слоя	Материал слоя					
обозначение слоя		Марка	ГОСТ, ОСТ, ТУ	Электрическая характеристика	Метод нанесения		
	Проводники и контактные площадки	Нихром X20 H80	ГОСТ 10994—74	0.04 Om	Фотолитографический		
		Золото Зл9999	ΓΟCT 6835-72	0.04 OM	Фотолитографический		
	Резистивный слой	Сплав PC—3001	ETO.021019 TY	10 кОм	Фотолитографический		
	Защитный слой	Фоторезист негативн. ФН—11	TY-14-631-7B				

1. Размеры для справок (мм).

инв.

- 2. Элементы в слоях выполнять по координатам, приведенным в таблицах на соответствующих листах
- 3. Характеристики отдельных слоев приведены в табл. 1. 4. Номера контактных площадок и обозначение элементов показаны условно и соответствуют схеме электрической принципиальной АБ. XXXXXX 001 ЭЗ.

gama							АБ. XXXXXX. 002 CБ				
Nogn. u								Лит.		Масса	Масштаб
		Изм.	Лист	докум.	Подп.	Дата	Резистивная микросборка				
		Разраб.		Юрьев Д.С.			Сборочный чертеж				10:1
подл.		Пров. Т. контр. Н. контр.					2 2 2 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3				
								Лист .		Лист	Листов 5
ž										11141/ 1401	1
Инв.								НИУ МЭИ ЭР—15—15			
		Уm	в.								